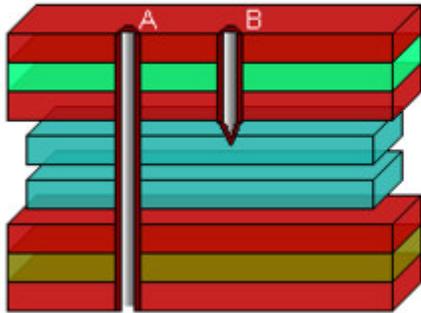


### Lagenaufbau

Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1	Cu+galv.Cu	0.25	18+25	
	HF Tr-Lam		18	
2	Cu	0.068		1080
	FR4 Prepreg			1080
3	FR4 Prepreg	1.00	18	
	Cu			
4	FR4 Tr-Lam		18+25	
	Cu+galv.Cu			



Presslingsdicke *	1,43	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske *	1,54	+/- 10%

### Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- \* Dickenberechnung bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe
- unsymmetrischer Mischaufbau - Verwindung / Wölbung > 0,75% möglich

### Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm
	Viapad-Ø	≥ 500 µm

Sacklöcher [B] (mechanical blind Vias)	End-Ø	≥ 400 µm
	Viapad-Ø	≥ 700 µm
Leiterbild Außenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
Leiterbild Innenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm